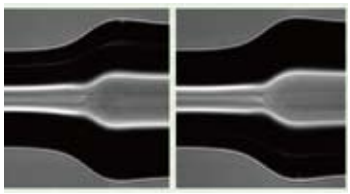
ハイエンド光ファイバ融着接続機　S183PMⅡ（異径、定偏波、高強度、大口径光ファイバ接続用）

NEW

■ハイエンドパフォーマンス
■あらゆる接続ニーズに対応
（異径、定偏波、高強度、大口径光ファイバ接続）
■クラッド径500μmまで接続
■パンダ光ファイバを最速35秒で高速融着接続
■充実した拡張性
■測定器と連動した融着接続、融着データの文書化、パソコン接続によるデータ伝送が可能
■簡単操作で確実な接続が可能
■光機器製造における生産性、信頼性を向上
■光ファイバの被覆外径やクラッド径が変わっても自動調整
■簡単操作パネル



光コンポーネントや光部品の研究・開発および製造ラインで要求される全てのニーズをフィードバックした高機能、高性能・ハイエンドの融着接続機です。定偏波保存光ファイバやエルビウム添加ファイバ、ハイデルタファイバの接続はもちろん、細径クラッド（80μm）や500μmといった太径クラッドなどの異径の光ファイバ接続も可能です（汎用のクラッド径は125μm）。さらに高強度接続用工具（専用のファイバ切断器、皮剥き器、洗浄器）とあわせて使用することで、高強度接続（平均25N）も行えます。

■仕様

項目	特性
適用光ファイバ	SMF、MMF、DSF、NZDF、CSF、DCF、EDF、PMF、LDF
光ファイバ切断長	3～5mm（被覆クランプ）、9～11mm（ガラスクランプ）
光ファイバクラッド	80～500μm
光ファイバ被覆外径	160～2000μm
平均接続損失（同種接続）	SM：0.02dB、MM：0.01dB、DSF：0.04dB、PM：0.05dB
平均接続損失（異種接続）	0.05dB（SM ／PANDAファイバ接続時）、0.15dB（SM ／DSFファイバ接続時）、0.10dB（SM ／PMファイバ接続時）
消光比（同種接続）	40dB（0.6度）（PANDAファイバ接続時）、32dB（1.4度）（BOW-TIEファイバ接続時）
消光比（異種接続）	30dB（1.8度）（PANDA ／BOW-TIEファイバ接続時）
標準融着接続時間	15秒（SMファイバ接続時）、35秒（PMファイバ接続時／ガラスクランプ）、55秒（PMファイバ接続時／被覆クランプ）
標準加熱補強時間	51秒（60mmスリーブ）、40秒（40mmスリーブ）、37秒（20mmスリーブ）
検査のパラメータ	切断角度、軸ずれ、傾き、コア曲がり、端面間隔、気泡
融着プログラム数	60（工場出荷設定）／ 150（総プログラム）
反射率	>60dB
強度	300kpsi（25N）高強度接続時
倍率	215倍／ 430倍
モニタ	6.5インチLCDモニタ
画像出力	アナログRGB（VGA）
データ通信	USB1.1およびイーサネット
融着データメモリ	最大2000心
寸法	350W×197D×154H mm
質量	8.5kg
AC入力電源	100～240V、50 ／ 60Hz（ACアダプタ使用）
使用環境条件	0～+40℃（結露のないこと）
保管環境条件	−40～+60℃（結露のないこと）

■標準構成品

品名	品番	数量
S183PMⅡ本体	S183-P2-A-0001	1台
250μm被覆用ファイバホルダ	S710S-250	1組
400μm被覆用ファイバホルダ	S710S-400	1組
900μm被覆用ファイバホルダ	S710S-900	1組
ACアダプタ	S974A	1個
AC電源コード	—	1本
予備電極棒	S960	1組
電極棒研磨用ゴム砥石（シャープナ）	—	1個
取扱説明書	—	1部

ご注意：S183PMⅡは、外国為替および外国貿易法（外為法）等に定められた規制貨物に該当します。 輸出する時、および国外に持ち出す時には同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要になります。